



⇒ INNOVATIVE TECHNOLOGIES REVOLUTIONIZE HIGH-PRECISION PROCESSING

●
第64期事業報告書

平成14年4月1日 ⇨ 平成15年3月31日

DISCO CORPORATION

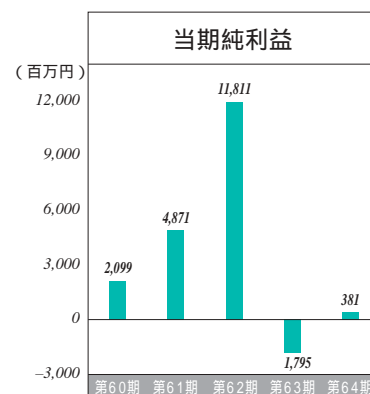
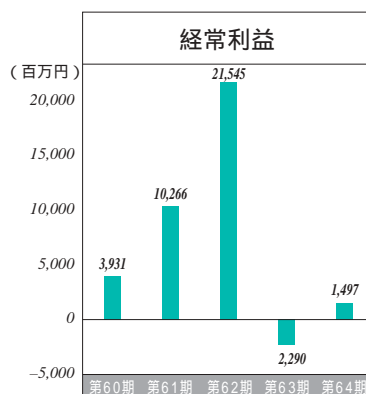
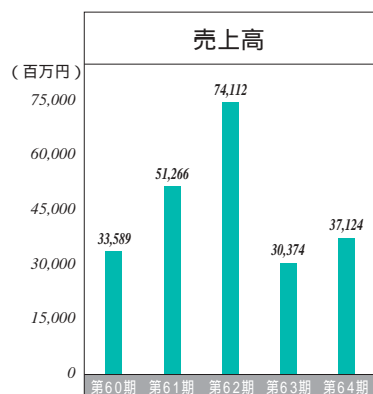


主要財務数値

(連結)

(単位 : 百万円)

	平成11年3月期 (第60期)	平成12年3月期 (第61期)	平成13年3月期 (第62期)	平成14年3月期 (第63期)	平成15年3月期 (第64期)
売上高	33,589	51,266	74,112	30,374	37,124
経常利益	3,931	10,266	21,545	2,290	1,497
当期純利益	2,099	4,871	11,811	1,795	381
1株当たり当期純利益(円)	99.93	230.41	367.76	55.91	11.80
株主資本	27,057	40,845	51,601	49,203	48,746
総資産	41,018	67,054	86,435	63,720	61,908
株主資本当期純利益率(ROE、%)	8.0	14.3	25.6	3.6	0.8



目次

主要財務数値	1
株主の皆さまへ	2
ISSUES and VIEWS	4
DISCO TODAY	5
部門別営業概況	7
業績のポイント(連結)	9
財務諸表(連結)	11
財務諸表(単独)	12
会社概要/役員	13
株式概要	14

株主の皆さまへ

厳しい経営環境の中、黒字転換を実現

当社の主な市場である半導体業界や電子部品業界におきまして、当期は、パソコンや携帯電話、デジタル家電など最終製品の在庫調整が概ね終了したことを受け、生産の回復が見られました。しかし、まだまだ地域別で見ても、製品種類別で見ても、まだら模様の状態で、力強い回復力には欠けています。これを受け、当社の属する半導体製造装置業界においても、前期比ではプラス基調にあったものの、半導体メーカーの設備投資スタンスにもまだまだ濃淡がある状況です。

このような状況のもと、当社はCS(顧客満足度)向上に取り組むとともに積極的な販売活動を展開した結果、特に消耗品である精密ダイヤモンド砥石の受注が回復に転じ、機械受注につきましても、未だ力強さには欠けますが、下期を中心に前期比回復傾向が鮮明となりました。この結果、当期の連結売上高は371億24百万円(前期比22.2%増)となりました。また、売上面での回復に加え、売上構成比の改善や、主に前下期より実施している各種のコスト削減効果が通年で奏功したことなどにより、連結営業利益は16億25百万円(前期比39億65百万円増)、連結経常利益は14億97百万円(前期比37億88百万円増)となりました。なお、連結子会社の財務健全化のため繰延税金資産に対する評価性引当金を計上したことにより、法人税等調整額での負担が高まり連結当期純利益は3億81百万円(前期比21億77百万円増)にとどまりましたが、いずれの段階でも黒字転換を果たし



代表取締役社長 溝呂木 育

ました。

配当につきましては、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定的な配当に努めるとともに、業績に応じて弾力的な還元策を図るという方針に基づき、当期につきましては普通配当を1株当たり20円(うち期末は10円)とさせていただきます。

なお、前期に実施したインセンティブプラン同様、役員や従業員の業績向上努力とそれに対する成果配分を株主利益により密接に関連付けることにより、業績向上と株主重視の経営を一段と進める狙いから、当社および子会社の役員・従業員の一部を対象とするストックオプションを導入いたしました。

「Kiru, Kezuru, Migaku」分野に経営資源を集中投入

低迷の時代にあっても、ディスクが超微細加工分野において業界リーダーとしてのポジションを確保しているのは、当社の高品質の製品やサービスがお客様から信頼され支持されているからであり、

この期待に応えることにより、結果として、ディスクはグローバルで圧倒的な市場シェアを確保しています。この高シェアを支えているものこそ、当社が1937年の創業以来、一貫して追求し続けている「Kiru, Kezuru, Migaku(切る、削る、磨く)技術」です。モノの加工には、ほぼ例外なく、切ったり、削ったり、磨いたり、というプロセスが必要になります。特に、半導体や電子部品などの超微細加工においては、精密加工の高い技術レベルと、さまざまな素材をさまざまな方法で加工する幅広い技術、応用力が求められます。

そして、多様なニーズの顧客に対してそれぞれ最適な加工結果、ソリューションを提供しなければなりません。機械と、それに装着する砥石、そしてこの両者を最適に組み合わせるアプリケーション技術。この三位一体の技術があってはじめてそれは可能となります。この三位一体の技術を有するのは世界中でディスコのみであり、そこに当社の優位性ひいては収益や事業拡大の機会があると考えております。この「Kiru, Kezuru, Migaku」という専門的ながら非常に応用範囲の広い分野に経営資源を集中投入することで、アウトプットを最大限に高め、優位性をより向上させるとともに事業の裾野拡大を図り、株主、取引先、従業員などのステークホルダーから歓迎されるよう企業価値の一層の向上を図ることを基本方針としております。

「DISCO VALUES」をもとに良質な企業文化を構築

当社は、経営には効率的な事業運営を行う「事業経営」と、それを支える企業文化や価値観を絶えず共有し続けるための「組織経営」があると考えております。前者のみを追求していると、経営者、従業員はつい近視眼的な誘惑にとらわれがちです。しかし、企業の社会的責任が問われる今、このような考え方は存亡の危機をも招きかねません。このような観点から、当社では「組織経営」すなわち企業の質的側面の充実を重視しています。

また、いわゆるコーポレートガバナンスのあり方については、委員会等設置会社への移行などといった制度面の導入だけでなく、企業実態や特性、規模その他さまざまな観点からトータルに考慮したうえで決定すべきものであると考えております。こうした考え方から、激動の時代にあっても経営者、従業員が方向性を見失うことのないよう、多年にわたって議論を積

み重ね、企業としての価値観である「DISCO VALUES」を策定し、経営者、従業員が絶えずこの価値観を共有し続けるための努力を重ねることで、良質な企業文化の構築・浸透に力を注いでおります。

半導体・電子部品の需要増でビジネスチャンスが拡大

企業のIT投資の回復、パソコンの買い替え需要の増加、携帯電話の高品位化（カラー化・カメラ付き・大容量化など）、自動車の電装化の進展などに伴い、中期的には半導体・電子部品の需要が拡大していくものと思われます。また、質的にも新たな加工方法の登場など顧客から要求される技術レベルも変化を遂げてきております。

こうした流れは、当社にも大きなビジネスチャンスをもたらしており、来期はダイシングソーやグラインダーの300mmウェーハ対応機種、ウェーハメーカー向けグラインダー、極薄チップを加工するためのDBG（Dicing Before Grinding）システムやドライポリッシャーなどの需要拡大による売上増に期待しています。

「Kiru, Kezuru, Migaku」という技術領域は、極めて広く多様で、今後とも裾野が拡大していくことが期待できます。当社は今後も、市場のボリュームへの追随だけでなく、チップ薄型化やパッケージング技術の革新、ウェーハメーカーでのグラインダー需要への対応など、質的・技術的なニーズに対応した製品をタイムリーに投入していくことにより、市場の成長をアウトパフォームしていきたいと考えております。

株主の皆さまにおかれましては、より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

ISSUES and VIEWS は、株主の皆さまから寄せられるさまざまなご質問にお答えするコーナーです。今回は、以下の3つのご質問にお答えします。



収益の柱が電子業界関連製品ひとつであることに問題はありますか？現在の収益構造に対する考え方は？



当社はコア技術を「Kiru, Kezuru, Migaku」(切る、削る、磨く)の分野に絞り、この範囲の技術に特化していくことを方針としています。現在これらの技術が電子業界関連製品の発展に役立っています。「高度なKiru, Kezuru, Migaku」に対する市場ニーズは極めて多様です。対象マーケットも、半導体のみではなく、各種の電子部品など多岐にわたっているのです。また、地域的にも多極化を図ることにより、収益の安定性を保っています。今後も、技術革新や変動の激しい業界で当社がトップを走り続けていくには、得意分野である「Kiru, Kezuru, Migaku」分野に経営資源を集中投入していくことが最善の策と考えています。

収益構造において当社が他の半導体製造装置メーカーと大きく異なるもうひとつの点は、シリコンサイクルなどによる需要変動が相対的に小さく、収益性の良い精密ダイヤモンド砥石という消耗品ビジネスを持っていることです。これにより安定的な売上を維持し、当社の収益を下支えています。



今後、技術開発競争と併せて価格競争も激しさを増すものと思われませんが、貴社の対応は？



半導体不況の長期化により、顧客からの価格面のプレッシャーは強くなっています。現状では、価格面での対抗措置をとらざるを得ないケースもありますが、競争に勝つために何よりも重要なことは「いかに顧客ニーズにマッチしたソリューションを迅速に提供しCS向上を図る

か」であると考えています。高度な技術を必要とする生産財ですから、単に安ければ売れるというものではありません。半導体メーカーや電子部品メーカーのニーズは多種多様で、特殊仕様も必ず要求されます。常に他社に先駆けて新製品を開発し、それをタイムリーに市場投入していくとともに、常に顧客ニーズにマッチしたソリューションを提供し続けることが、価格低下の圧力に対抗していく方法であると考えています。



レーザーソーの今後の展開については、どのように考えていますか？



当年に発表したレーザーソーについては、今のところ最先端デバイスの開発を行っている一部のデバイスメーカー向けに開発機が出る程度ですが、将来的には収益貢献度も高まるものと思われしますので、鋭意研究を進めていきたいと考えています。

既存の砥石マーケットがレーザーソーに食われるのでは？というご質問をいただくことがありますが、現状においてレーザーソーは、技術面でブレードでは対応できない限られた用途での使用となる見込みであり、既存のアプリケーションとは競合しないと考えています。また、顧客サイドのコスト面からも、ブレードでの対応が可能な加工については、引き続きブレードでの切断が中心となるでしょう。

レーザーソーに関しては、今後もブレードでは対応できない領域(曲線加工、3D的な加工、穴あけ、サファイア、ジルコニアといったダイヤモンド加工では困難な難研削材など)でその可能性を追求し、将来的にこのような分野にアプリケーションを拡張していきたいと考えています。

DISCO TODAY

ディスコの企業像をさまざまな側面から紹介する DISCO TODAY。
今回はDBG (Dicing Before Grinding) システムとレーザーソーについてご紹介します。

●
DBG システムが、
超薄型 IC の加工を
可能にしました。

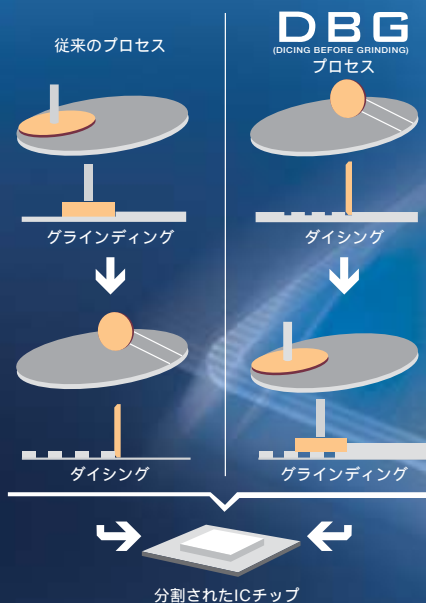
300mm ウェーハや薄型ICなど最先端半導体デバイスの開発により、半導体製造工程においても最先端の加工技術が求められています。こうした要求に応えディスコが開発したDBGシステムとレーザーソーは、極薄加工や新素材の加工に大きな可能性を開きました。

300 mm対応
DBG インラインシステム
DBGシステムは、ウェーハの極薄化とチップ分割を同時に行うので、ウェーハ径が大きくなってもチップの極薄化が可能です。今後、主流となる300mm径などの大口徑ウェーハの極薄加工には最適のシステムです。

ディスコの薄ウェーハ加工技術

従来のICチップ加工方式は、グラインディングの後にダイシングをしてウェーハからICチップをバラバラに切り離すというものでした。しかし、この方法ですと、50ミクロン以下といった極薄チップの場合、ダイシング時に、ウェーハ裏面のカケや破損などの問題がありました。DBG プロセスは、方式を逆転させ、先にダイサーで切れ目を入れておき、最後にウェーハの反対側からグラインダーで研削を行うことによってチップを非常にきれいに分割する方式です。これによって、切断時のチップ損傷が大幅に低減し、高品質の極薄チップの加工が可能となりました。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING



グラインディングホイール

DBG システム

最先端技術を有する大手半導体メーカーを中心にDBGシステムの需要が伸びています。極薄チップの現在の主な用途は、チップ積層のための薄型化やICカード向けチップの加工などですが、将来的には、紙幣の中に入れるICチップやRFIDタグなど、さらに用途が拡大していくものと思われます。

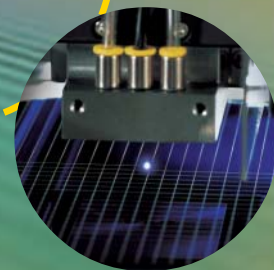
レーザーソーが、
Low-k 膜使用の
ウェーハダイシングを
容易にしました。

DFL7160

当期に発表した最大対応
ウェーハ径 300mm のレー
ザーソー。主なアプリケー
ションはCu配線やLow-k膜の
グルーピング。ショートパル
スレーザーによる非熱加工。
ブレードのダイシングソーと
同じプラットフォームを採用
しており、オペレーターの技
術修得も容易。



LASER SAW



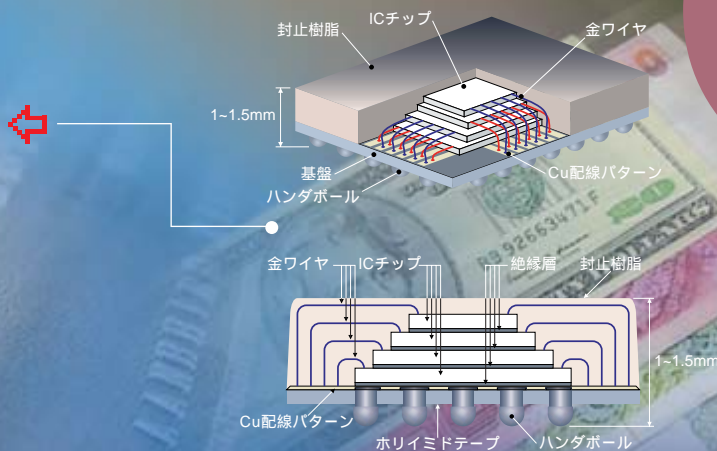
レーザー切断加工

→ ディスコのレーザー技術

高速大容量の最先端半導体デバイスでは、シリコン表面に誘電率の低いLow-k膜が使用されるケースが増えています。この膜は、非常に脆く、他の材料となじみにくい(密着性が良くない)という特色があります。したがって、Low-k膜を使用したCu配線構造は、非常に強度が弱く、ブレードでのダイシング時にLow-k膜と配線材料が剥離しやすいという問題がありました。当社はこれを解決するため、物理的なストレスのかからないレーザーによる方法を開発しました。それが、2002年12月、セミコン・ジャパンで発表したレーザーソー DFL7160です。まずシリコン表面のLow-k膜をDFL7160の短パルスレーザーでグルーピングし、次に、ブレードでシリコンを従来どおり切断するものです。Low-k膜をグルーピングするこのプロセスを追加することにより、その後のブレードによるダイシング工程で高速切断が可能となり、スループットの向上が図れます。

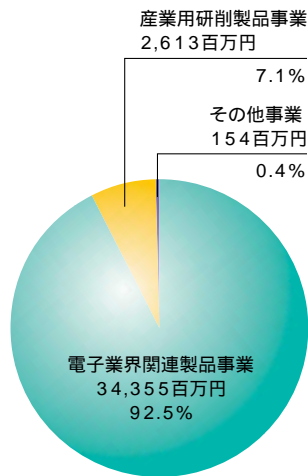
今後想定されるレーザーソーの用途としては、ブレードでは対応不可能な、曲線加工、3D的な加工、穴あけのほか、サファイア、ジルコニアといった難研削材の加工などが考えられます。

スタックド・パッケージ
技術的にきわめて要求の強い
積層形の新しいAdvanced
Packaging。これは4層です
が、将来的には7層や10層も
考えられています。



部門別営業概況

第64期 部門別売上構成 (%)



ダイシングソー

電子業界関連製品事業

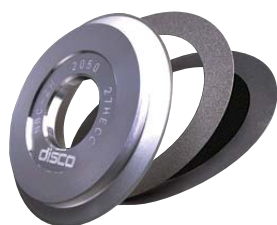
電子業界関連製品部門は、当社主力製品であるダイシングソー、サーフェスグラインダー、精密ダイヤモンド砥石、精密電子部品等の製造・販売を行っています。販売先も半導体メーカーや電子部品メーカーなどが占めており、当社の連結売上高の92.5%、全事業合計の連結営業利益の97.0%を占める中核セグメントです。

最近の技術動向の特徴としては、Low-k膜などの新しい素材加工、チップの薄型化へのニーズの高まり、ウェーハの300mm化の進展などがあります。こうした動向に対応して当期は、Low-k膜をブレードでダイシングする前にレーザーで除去するレーザーソーDFL7160、従来機種よりも生産性などを向上させたセミオートのダイシングソーDAD3350など、5機種を開発しました。

当期の業績につきましては、半導体市場における生産数量の回復を受け、消耗品である精密ダイヤモンド砥石の受注・売上高が期初より好調に推移しました。加えて、上期は低迷していた機械も下期には受注・売上高が改善しました。特に、半導体メーカーの稼働率向上に伴うダイシングソーの需要や、極薄チップ加工向けにDBG(先ダイシング)インラインシステム、DBG仕様のグラインダーなどへの需要が伸びました。

地域別では、通期で見ると、台湾、シンガポール、日本などの売上高の改善が特に顕著でした。これらの地域では、300mmウェーハ対応装置や、カメラ付き携帯電話に搭載される液晶ドライバー、CCDなど半導体デバイス向け製品の売上が伸びました。

この結果、当期の売上高は343億55百万円(前期比26.3%増)となり、営業利益は43億23百万円(前期比754.6%増)となりました。



精密ダイヤモンド砥石



産業用ダイヤモンド砥石

来期においては、当期に一服感のあったウェーハメーカー向けグラインダーが、ウェーハの300mm化の進展に伴い再び増勢に転じていくものと見込んでいます。300mm対応ダイサーについては、まだ後工程への300mm投資が緒に就いたばかりであり、来期も引き続き期待しております。また、近年、CSPというチップ並みの大きさまで小型化したパッケージが増加していますが、このCSPでは、チップの切断に加えパッケージの切断をダイサーで行う方法が浸透しており、今後ともパッケージ切断向けダイサーへの需要増が見込まれます。

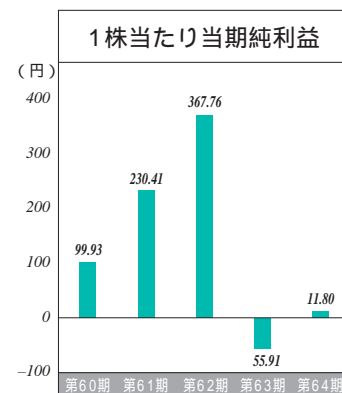
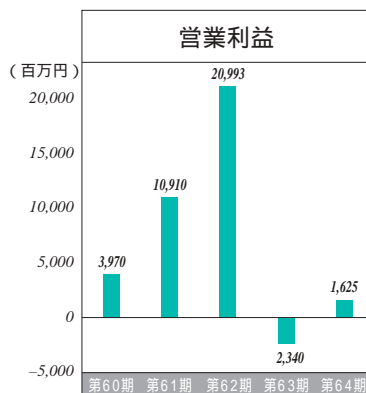
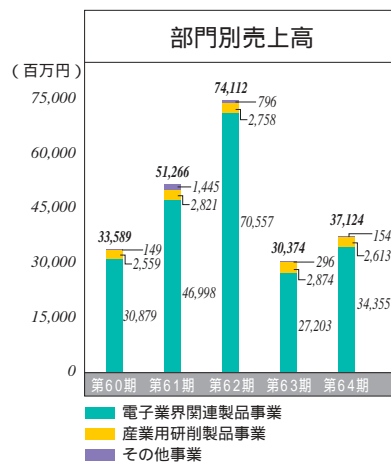
産業用研削製品事業

当部門は、ダイヤモンドホイール、研削切断砥石等、主として建築・土木業界向けの研削切断工具の製造・販売を行っています。当期は、積極的な販売活動を展開しましたが、国や地方公共団体による公共事業抑制策などの影響を受け、売上高は26億13百万円(前期比9.1%減)となりました。なお、コスト削減に努めた結果、営業利益は1億29百万円(前期比69.2%増)となりました。

その他事業

当事業は、半導体製造装置メーカー等向けのコンピュータソフトの設計・販売を手がける子会社が担っています。当期には前期のような大口の受注が入らず、売上高は1億54百万円(前期比47.8%減)、営業利益は4百万円(前期比85.9%減)となりました。

業績のポイント(連結)



部門別売上高

前期は電子業界関連製品事業の売上高が、半導体不況に伴い大幅に落ち込みましたが、半導体市況の回復に伴い主要製品である機械や消耗品の売上高が改善し、当期は前期比26.3%増となりました。この結果、全体の連結売上高は前期比22.2%増となりました。

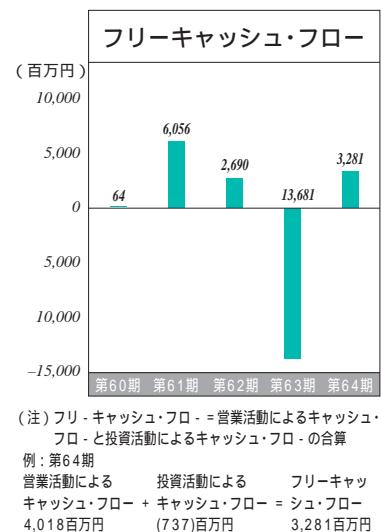
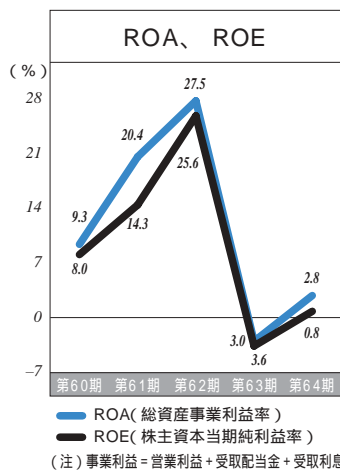
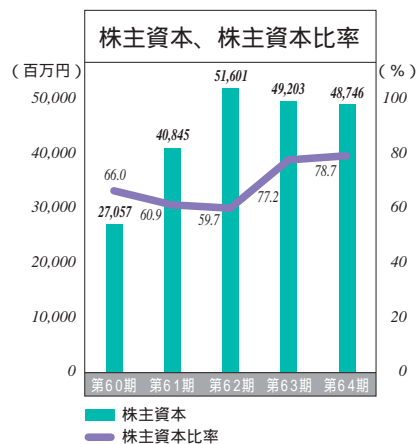
営業利益

売上高の回復と、前下期から実施した各種のコスト削減効果が通年で奏功したこと、製品構成の改善や操業度の向上により売上高総利益率が改善したことから、営業利益は黒字転換しました。中核部門である電子業界関連製品事業における営業利益の回復が全体を牽引しました。

1株当たり当期純利益

当社は第62期において、1:1.5の株式分割を実施しています。

当期は利益面の回復により1株当たり当期純利益が前期のマイナスからプラスに転じましたが、当期純利益が子会社の繰延税金資産取り崩しにより圧迫されたことから、11.80円にとどまりました。



株主資本、株主資本比率

株主資本は配当金などの社外流出を主因として、前期比で4億57百万円減少しました。総資産に占める株主資本の比率(株主資本比率)は、棚卸資産の削減などにより借入金の圧縮を進めた結果、前期比1.5ポイント改善し、78.7%となりました。

ROA、ROE

総資産から得られる収益率であるROAと、株主資本から得られる収益率であるROEはいずれもマイナスであった前期より改善しましたが、当期の利益水準を反映してROA 2.8%、ROE 0.8%にとどまりました。

フリーキャッシュ・フロー

各期のキャッシュ創出能力を示すフリーキャッシュ・フローは、第63期に損益面の悪化と投資支出増加などにより前期比大幅に悪化しましたが、第64期は、利益水準の改善、棚卸資産の圧縮、設備投資の抑制などを受け、大幅に改善しました。

財務諸表(連結)

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第63期 (平成14年3月31日現在)	第64期 (平成15年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	7,762	6,666
受取手形及び売掛金	8,526	11,310
有価証券	20	—
棚卸資産	18,561	15,954
その他	2,255	1,976
流動資産合計	37,126	35,908
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,863	8,208
機械装置及び運搬具	3,096	2,942
土地	5,720	5,722
その他	1,857	2,734
有形固定資産合計	19,538	19,608
無形固定資産		
無形固定資産	953	800
投資その他の資産		
投資有価証券	1,345	1,459
その他	4,755	4,132
投資その他の資産合計	6,101	5,592
固定資産合計	26,593	26,000
資産合計	63,720	61,908
(負債の部)		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,077	3,787
短期借入金	5,473	1,634
未払法人税等	675	365
その他	2,740	3,538
流動負債合計	10,967	9,326
固定負債		
新株引受権付社債	312	312
長期借入金	733	966
退職給付引当金	1,529	1,596
その他	919	882
固定負債合計	3,494	3,757
負債合計	14,462	13,084
(少数株主持分)		
少数株主持分	54	77
(資本の部)		
資本金	9,770	9,772
資本剰余金	10,637	10,638
利益剰余金	28,794	28,529
その他有価証券評価差額金	57	18
為替換算調整勘定	51	204
自己株式	4	9
資本合計	49,203	48,746
負債、少数株主持分及び資本合計	63,720	61,908

(注)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の改正に伴い、連結貸借対照表、連結剰余金計算書の記載方法が変更されました。そのため前期の計数を組み替えて表示しています。

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	第63期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	第64期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
売上高	30,374	37,124
売上原価	17,781	20,344
販売費及び一般管理費	14,932	15,153
営業利益	2,340	1,625
営業外収益	471	409
営業外費用	422	537
経常利益	2,290	1,497
特別利益	90	149
特別損失	632	153
税金等調整前当期純利益	2,833	1,493
法人税、住民税及び事業税	370	589
過年度法人税等戻入額	581	—
法人税等調整額	801	579
少数株主損失	24	56
当期純利益	1,795	381

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(単位：百万円)

科目	第63期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	第64期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,655	4,018
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,025	737
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,455	4,239
現金及び現金同等物に係る換算差額	97	137
現金及び現金同等物の減少額	11,128	1,096
現金及び現金同等物の期首残高	18,891	7,762
現金及び現金同等物の期末残高	7,762	6,666

連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科目	第63期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	第64期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	10,637	10,637
資本剰余金増加高	—	1
新株引受権の権利行使による増加高	—	1
資本剰余金期末残高	10,637	10,638
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	31,472	28,794
利益剰余金増加高	320	381
連結除外による増加高	320	—
当期純利益	—	381
利益剰余金減少高	2,999	646
配当金	1,124	642
役員賞与	79	4
当期純損失	1,795	—
利益剰余金期末残高	28,794	28,529

財務諸表(単独)

貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第63期 (平成14年3月31日現在)	第64期 (平成15年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	4,442	3,413
受取手形	462	651
売掛金	4,992	8,153
有価証券	20	—
棚卸資産	15,479	12,745
その他	5,407	4,345
流動資産合計	30,805	29,309
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,292	6,679
機械及び装置	2,758	2,590
土地	4,983	4,983
その他	1,794	2,684
有形固定資産合計	16,829	16,938
無形固定資産	687	540
投資その他の資産		
投資有価証券	861	785
関係会社株式	2,835	4,296
その他	4,148	3,832
投資その他の資産合計	7,845	8,914
固定資産合計	25,362	26,392
資産合計	56,168	55,702
(負債の部)		
流動負債		
支払手形	837	1,295
買掛金	528	1,378
短期借入金	3,000	400
未払金	843	1,499
未払法人税等	39	18
その他	1,000	1,247
流動負債合計	6,249	5,839
固定負債		
新株引受権付社債	312	312
退職給付引当金	1,353	1,399
その他	844	812
固定負債合計	2,510	2,523
負債合計	8,759	8,363
(資本の部)		
資本金	9,770	9,772
資本剰余金	10,637	10,638
資本準備金	10,637	10,638
利益剰余金	26,948	26,917
利益準備金	594	594
任意積立金	17,037	17,031
当期末処分利益	9,316	9,292
その他有価証券評価差額金	57	18
自己株式	4	9
資本合計	47,408	47,339
負債及び資本合計	56,168	55,702

損益計算書

(単位：百万円)

科目	第63期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	第64期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
売上高	19,349	25,614
売上原価	11,124	13,990
販売費及び一般管理費	11,410	11,154
営業利益	3,185	469
営業外収益	2,852	891
営業外費用	126	244
経常利益	459	1,116
特別利益	15	89
特別損失	607	136
税引前当期純利益	1,051	1,070
法人税、住民税及び事業税	127	62
過年度法人税等戻入額	574	—
法人税等調整額	520	395
当期純利益	83	612
前期繰越利益	9,721	9,000
中間配当額	321	321
当期末処分利益	9,316	9,292

利益処分

(単位：百万円)

科目	第63期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	第64期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
当期末処分利益	9,316	9,292
任意積立金取崩高	5	4
買換資産圧縮積立金取崩高	5	4
国庫補助金等圧縮積立金取崩高	0	0
合計	9,322	9,296
利益処分額	321	322
配当金	321	321
買換資産圧縮積立金	—	1
国庫補助金等圧縮積立金	—	0
次期繰越利益	9,000	8,974

(注)「商法施行規則」の改正に伴い、貸借対照表の記載方法が変更されました。そのため前期の計数を組み替えて表示しています。

会社概要

社名	株式会社ディスコ DISCO CORPORATION
本店所在地	東京都大田区東糀谷二丁目14番3号
創業年月日	1937年5月5日
設立年月日	1940年3月2日
資本金 (2003年3月31日現在)	9,772百万円(32,117,999株) 東京証券取引所市場第一部 証券コード6146
従業員 (2003年3月31日現在)	1,068名
主な事業内容	1. 超砥粒砥石および人造研削砥石の製造ならびに販売 2. 精密機械・半導体製造用機器および付属機器の製造ならびに販売 3. 各種精密部品・工具・治具・ゲージの製造ならびに販売 4. 電気機器・自動制御機器の製造ならびに販売 5. 医療器具の製造ならびに販売 6. タイルの製造ならびに販売 7. 前各号に付帯する一切の事業
事業所	本社 広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場)
国内拠点	大阪支店、九州支店、仙台営業所、名古屋営業所、諏訪営業所

海外拠点	DISCO HI-TEC AMERICA, INC. USA Head Office Eastern Regional Sales & Service Office Southeastern Regional Sales & Service Office Central Regional Sales & Service Office Southwestern Regional Sales & Service Office Northwest Regional Sales & Service Office DISCO HI-TEC EUROPE GmbH Europe Head Office DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC UK LTD. DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE, LTD. South Asia Head Office DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. Beijing Service Office Guangdong Service Office
関連会社	株式会社ディスコ エンジニアリング サービス 株式会社テクニスコ 株式会社ディスコ アプレイシブ システムズ 株式会社ディーエスディー 株式会社ダステック DD DIAMOND CORPORATION S.E.A. UTENSILI DIAMANTATI S.p.A. DISCO-SEA AMERICA, INC. DISCO-SEA EUROPE S.r.l.

役員 (平成15年6月26日現在)

代表取締役会長	関家 憲一
代表取締役社長	溝呂木 斉
常務取締役	関家 圭三
常務取締役	関家 一馬
取締役	中山 勉

取締役	関家 英之
取締役	梶山 啓一
取締役	溝呂木 隆夫
取締役	田村 隆夫

常勤監査役	玉利 晋
常勤監査役	古川 深志
監査役	浅海 芳久
監査役	木谷 孟

株式概要 (平成15年3月31日現在)

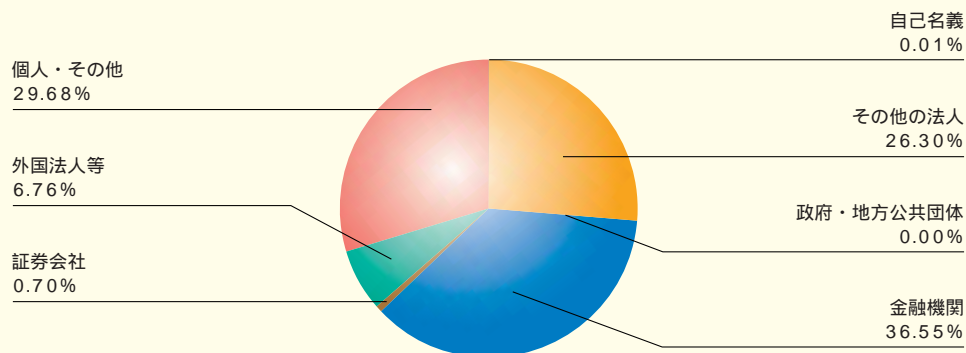
上場証券取引所 東京証券取引所 市場第一部(証券コード6146)

発行済株式総数 32,117,999株

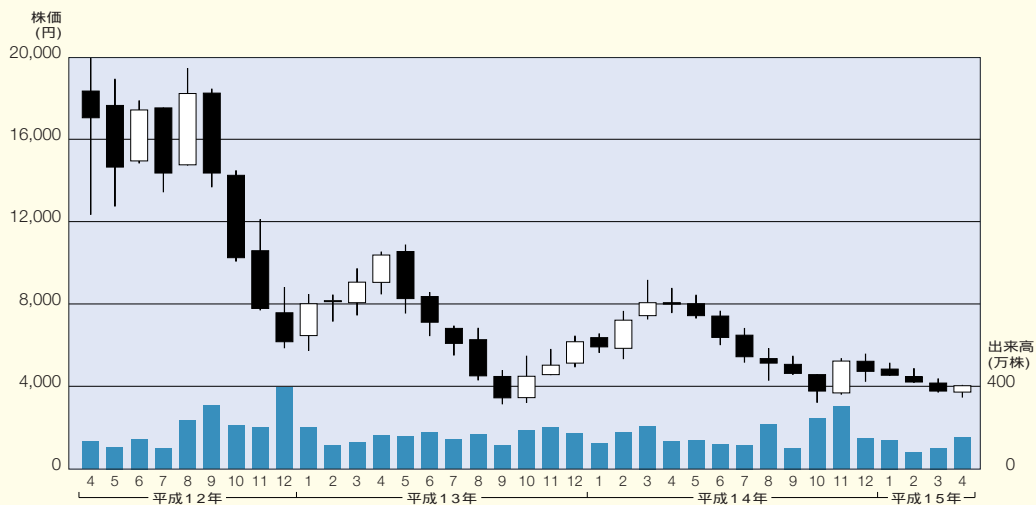
株主数 13,916名

大株主	株数	割合	大株主	株数	割合
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	2,676千株	8.33%	関家 臣二	1,434千株	4.46%
株式会社ダイイチ企業	1,998千株	6.22%	野村信託銀行株式会社	1,287千株	4.01%
株式会社ダイイチホールディングス	1,998千株	6.22%	関家 憲一	1,036千株	3.23%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,816千株	5.66%	株式会社UFJ銀行	943千株	2.94%
株式会社第一総業	1,749千株	5.45%	日本生命保険相互会社	901千株	2.81%

所有者別分布状況



株価チャート



株 主 メ モ

決 算 期	毎年3月31日
定 時 株 主 総 会	毎年6月
利益配当金受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金受領株主確定日	毎年9月30日
名 義 書 換 代 理 人	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 UFJ信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 所	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL (03) 5683-5111(代表)
同 取 次 所	UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
公 告 掲 載 新 聞	日本経済新聞

ホームページアドレス

<http://www.disco.co.jp/>



お 知 ら せ

商法改正により、本年4月1日から株券失効制度が実施されました

株主さまがご所有の株券を紛失された場合、従来は裁判所に公示催告の申立を行い、除権判決を受けていただく必要がございましたが、今般、当社の名義書換代理人であるUFJ信託銀行に対して紛失株券を無効とするための「株券喪失登録」を申請し、1年の間異議申出が無ければ株券を再発行できることとなりました。

詳しくはUFJ信託銀行証券代行部までお問い合わせください。

配当金の税制が変わります

平成15年度税制改正により、

平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に株主さまが受け取る当社配当金につきましては、源泉徴収率は10%となります。少額配当申告不要制度の上限規制が撤廃され、当社の年間配当受取額が10万円を超える場合、または1回の配当金で受け取る金額が5万円を超える場合も、源泉徴収のみで納税を完了できるようになりました。また、確定申告をして配当税額控除を適用のうえ、総合課税を選択することも可能です。

(当社の発行済株式総数の5%超を所有する個人の株主さまを除きます)

源泉分離選択課税制度(35%源泉徴収)は、平成15年3月31日をもって廃止されました。

詳しくはお近くの税務署にご確認ください。

株式に関するお手続き用紙のご請求について

株式に関するお手続き用紙(届出住所・印鑑・姓名等の変更届、配当金振込指定書、単元未満株式買取請求書、名義書換請求書等)書類のご請求につきましては、上記名義書換代理人にてお電話ならびにインターネットにより24時間受け付けておりますので、ご利用ください。

0120-24-4479 (本店証券代行部)

0120-68-4479 (大阪支店証券代行部)

} 通話料無料

インターネットアドレス <http://www.ufjtrustbank.co.jp/>

なお、株券保管振替制度をご利用の株主さまは、お取引口座のある証券会社にご照会ください。

<買増し制度>

定時株主総会で定款変更議案をご承認いただきましたので、単元未満株式の買増しの取り扱いが可能となりました。1単元(100株)に満たない株式を所有されている株主さまで、買増しをご希望される株主さまは、UFJ信託銀行証券代行部、またはお取引口座のある証券会社にお申しください。